Fiche de données

CH20M22 B SIM BK/OR 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



L'élément de base du boîtier modulaire CH20M offre un certain nombre d'avantages qui en font un excellent choix pour vos projets. Avec des coupes spéciales pour les contacts de bus et FE, il est particulièrement flexible et adaptable.
Un autre point positif est la possibilité d'impression laser sur le boîtier, qui vous offre une haute précision et des options de conceptions individuelles. Une large gamme de couleurs est également disponible afin que vous puissiez concevoir le boîtier entièrement selon vos souhaits.
Le boîtier CH20M est également adapté pour les rails profilés standards, ce qui facilite la construction et l'intégration dans les systèmes existants.

Informations générales de commande

Version	Boîtiers du rail profilé, OMNIMATE Housing - série CH20M noir, Élément latéral, carte micro-SIM de préparation de raccordement (3FF), Largeur: 22.5 mm
Référence	2743520000
Type	CH20M22 B SIM BK/OR 2010
GTIN (EAN)	4064675313168
Qté.	10 Pièce

Fiche de données

CH20M22 B SIM BK/OR 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	108 mm	Profondeur (pouces)	4.252 inch
Hauteur	109.3 mm	Hauteur (pouces)	4.3031 inch
Largeur	22.5 mm	Largeur (pouces)	0.8858 inch
Poids net	40 g		

Températures

Température ambiante	-25 °C...85 °C	plage de température d'utilisation	-40...120 °C
Humidité	5 - 93 % d'humidité rel., Tu = 40 °C, pas de condensation		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau isolant	PA 66 GF 30
Groupe de matériaux isolants	I	Surface	non traité
Matériau de base	Plastique	Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	600 ≤ CTI

Caractéristiques générales

Couleur	noir	Degré de protection	IP20 en condition installée
Barrette de liaison équipée	TS 35	Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011
Possibilité d'enrobage	Non		

Propriétés d'assemblage

Nombre d'emplacements pour les connecteurs femelles de l'assemblage monté, max.	6	Nombre de circuits imprimés, max.	1
Nombre de niveaux de raccordement, max.	3	Nombre de pôles, max.	24
Hauteur des composants sur le circuit imprimé, max.	16.1 mm	Type d'assemblage du circuit imprimé	double face

Tests mécaniques

Selon la norme	DIN EN 61373:1999 (choc et vibration)
Conditions du test	cinq logements installés à la suite, 200g de poids supplémentaire sur le PCB
Axes éprouvés	X, Y, Z

Test de choc	Conseils généraux sur les tests	Tous les tests mécaniques ont été effectués sur une installation type ou en tenant compte

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

		de la réglementation concernée. Les résultats spécifiés ne remplacent pas les tests pertinents pour l'approbation. Ce ne sont que des valeurs d'orientation.
	Catégorie de test	1
	Nombre de chocs par axe	3 en directions positive et négative
	Durée du choc	30 ms
	Accélération horizontale	30.00 m/s²
	Accélération verticale	30.00 m/s²
	Accélération longitudinale	50.00 m/s²
Test de vibration	Catégorie de test	1B
	Durée du test	5 heures par axe
	Accélération effective	7.9 m/s²

Tests thermiques

Tests thermiques	Conseils généraux sur les tests	Tous les tests thermiques ont été effectués sur une installation type ou en tenant compte de la réglementation concernée. Les résultats spécifiés ne remplacent pas les tests pertinents pour l'approbation. Ce ne sont que des valeurs d'orientation.
	Conditions du test	trois logements installés à la suite - pas d'espacement
	Axes de test	horizontal
	Température ambiante	70 °C
	Dissipation de puissance, max.	1.9 W
	Température ambiante	60 °C
	Dissipation de puissance, max.	2.35 W
	Température ambiante	40 °C
	Dissipation de puissance, max.	3.4 W
	Température ambiante	20 °C
	Dissipation de puissance, max.	4.5 W

Propriétés des composants

Couleur du pied encliquetable	Orange	Découpe dans la zone du pied encliquetable, comme préparation pour	Carte Micro SIM (3FF)
Nombre de niveaux de raccordement, max.	3		

Forme boîtier - Configuration requise pour IN

Tolérance du contour des circuits imprimés	±0,1 mm	Epaisseur du circuit imprimé	1.6 mm
Tolérance de l'épaisseur du circuit imprimé	±0,15 mm		

Options de personnalisation

Possibilité d'étiquetage spécifique au client	Oui	Processus de la commande client spécifique	Cf. directives dans la section téléchargements
Variantes de couleur	Davantage sur demande	Possibilités de traitement	Traitement laser

Note importante

Informations sur le produit	Le contour du circuit imprimé, les zones restreintes et d'autres informations relatives à la conception du circuit imprimé se trouvent dans la catégorie technologie de connexion sous les connecteurs mâles correspondants dans les téléchargements.

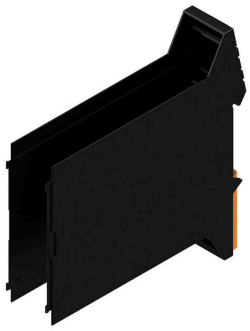
CH20M22 B SIM BK/OR 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

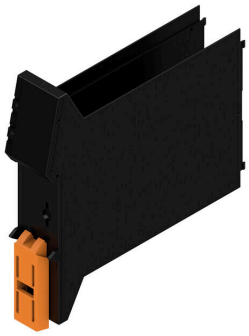
www.weidmueller.com

Dessins

Illustration du produit



Avantages produit



Élément de base avec découpe SIM

Dessin coté

